



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月29日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社

上場取引所 東

コード番号 6590 URL <http://www.shibaura.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 南 健治

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役経営管理本部長 (氏名) 道嶋 仁

TEL 045-897-2425

四半期報告書提出予定日 平成26年2月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	23,168	26.0	△521	—	△651	—	△820	—
25年3月期第3四半期	18,390	△34.7	△1,452	—	△1,585	—	△2,943	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 △708百万円 (—%) 25年3月期第3四半期 △2,923百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	△16.60	—
25年3月期第3四半期	△59.56	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第3四半期	45,599	14,987	14,987	32.9	303.34	
25年3月期	50,767	15,696	15,696	30.9	317.68	

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 14,987百万円 25年3月期 15,696百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では26年3月期の期末配当予想額は未定であります。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	36,300	19.4	700	—	400	—	300	—	6.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期3Q	51,926,194 株	25年3月期	51,926,194 株
26年3月期3Q	2,516,405 株	25年3月期	2,514,868 株
26年3月期3Q	49,410,555 株	25年3月期3Q	49,411,817 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

①業績全般について

当第3四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、円安基調の継続や経済政策への期待感があるものの、中国の経済減速不安など不透明な状況が続きました。液晶パネル業界はテレビ市場の低迷が続いていますが、中国において新規設備投資がありました。スマートフォンやタブレットなどモバイル機器の製品市場は好調であるものの、中小型パネル及びタッチパネル分野の設備投資には慎重な動きが見られました。

半導体業界は、先端分野への設備投資は堅調に推移しました。

このような景況下、当社グループは、液晶パネルや半導体での顧客拡大を図るとともに、新成長分野への展開を進め、前年同期との比較で売上が拡大しました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は23,168百万円（前年同期比26.0%増）、営業損失は521百万円（前年同期は営業損失1,452百万円）、経常損失は651百万円（前年同期は経常損失1,585百万円）、四半期純損失は820百万円（前年同期は四半期純損失2,943百万円）となりました。

②為替変動による影響

円安の進行により、当社の外貨建て受注契約案件の売上利益に対しては差益となり営業利益が増加しておりますが、一方で外貨建て資産・負債については為替差損を営業外費用に計上しております。合算相殺の結果、為替差益が発生しております。

③セグメントの業績について

（ファインメカトロニクス部門）

液晶パネル前工程では、中小型パネル及びタッチパネル分野の設備投資には慎重な動きが見られるものの、中国において新規設備投資もあり、対前年同期で売上が増加しました。

半導体前工程は、受注は進んだものの当第3四半期での売上には貢献できず、対前年同期で売上が減少しました。

この結果、当セグメントの売上高は12,664百万円（前年同期比7.7%増）、セグメント損失は215百万円（前年同期はセグメント利益268百万円）となりました。

（メカトロニクスシステム部門）

液晶パネルモジュール工程では、アウターリードボンダ及びタッチパネル貼合装置の売上が対前年同期で増加しました。

半導体組立工程は、ダイボンダの拡販により売上が対前年同期で増加しました。

この結果、当セグメントの売上高は7,531百万円（前年同期比90.4%増）、セグメント損失は320百万円（前年同期はセグメント損失1,692百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5,168百万円減少し45,599百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ5,523百万円減少し31,979百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ355百万円増加し13,619百万円となりました。これは主に建設仮勘定が増加したことによります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4,459百万円減少し30,611百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したことによります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ708百万円減少し14,987百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

液晶パネル業界は、一時的に中国において大型パネル分野の新規設備投資がありますが、全般的には厳しい状況が続くと予想されます。一方、中小型パネル及びタッチパネル分野は、スマートフォンやタブレットについて設備投資が継続していくと予想されます。

半導体業界は、先端分野への投資は堅調と予想され、当社は技術革新により同分野での売上拡大を図ります。

当社を取り巻く環境は依然として厳しいものがありますが、成長分野を中心に受注を加速し、売上の拡大に向けて取り組んでまいります。また、引き続きコスト構造改革と不要不急な固定費の削減を行い、利益率の向上を図ります。

通期の連結業績予想につきましては平成25年10月17日に公表しました業績予想の通りです。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,296	4,930
受取手形及び売掛金	24,545	19,286
電子記録債権	527	2
商品及び製品	2,351	2,076
仕掛品	4,098	4,354
原材料及び貯蔵品	195	168
繰延税金資産	787	578
未収入金	522	305
その他	232	322
貸倒引当金	△54	△44
流動資産合計	37,503	31,979
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	28,433	28,434
減価償却累計額	△17,830	△18,231
建物及び構築物(純額)	10,602	10,203
機械装置及び運搬具	2,061	2,454
減価償却累計額	△1,474	△1,746
機械装置及び運搬具(純額)	586	708
工具、器具及び備品	465	527
減価償却累計額	△406	△438
工具、器具及び備品(純額)	59	89
土地	119	119
リース資産	710	502
減価償却累計額	△468	△330
リース資産(純額)	242	172
建設仮勘定	207	910
有形固定資産合計	11,817	12,203
無形固定資産		
のれん	9	—
特許権	322	349
リース資産	23	10
その他	359	312
無形固定資産合計	715	672
投資その他の資産		
投資有価証券	241	155
長期前払費用	6	6
繰延税金資産	117	215
その他	376	377
貸倒引当金	△10	△10
投資その他の資産合計	731	744
固定資産合計	13,263	13,619
資産合計	50,767	45,599

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,500	8,263
短期借入金	11,742	7,730
1年内返済予定の長期借入金	—	1,000
リース債務	102	63
未払法人税等	59	64
未払費用	2,021	2,089
前受金	828	635
役員賞与引当金	—	15
受注損失引当金	17	10
資産除去債務	11	11
その他	529	386
流動負債合計	23,813	20,270
固定負債		
長期借入金	2,700	1,700
リース債務	181	134
長期未払金	21	19
退職給付引当金	4,801	4,933
役員退職慰労引当金	11	10
修繕引当金	450	450
資産除去債務	33	33
長期預り保証金	3,057	3,057
固定負債合計	11,257	10,340
負債合計	35,070	30,611
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,761	6,761
資本剰余金	9,995	9,995
利益剰余金	514	△306
自己株式	△1,720	△1,720
株主資本合計	15,550	14,730
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	56	46
為替換算調整勘定	89	210
その他の包括利益累計額合計	146	257
純資産合計	15,696	14,987
負債純資産合計	50,767	45,599

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	18,390	23,168
売上原価	14,359	17,947
売上総利益	4,031	5,221
販売費及び一般管理費	5,483	5,742
営業損失(△)	△1,452	△521
営業外収益		
受取利息	8	8
受取配当金	4	3
投資有価証券売却益	—	52
助成金収入	122	—
保険解約返戻金	—	30
その他	55	40
営業外収益合計	190	135
営業外費用		
支払利息	127	117
為替差損	135	38
その他	60	110
営業外費用合計	323	265
経常損失(△)	△1,585	△651
特別損失		
事業構造改善費用	858	—
特別損失合計	858	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△2,443	△651
法人税、住民税及び事業税	31	42
法人税等調整額	468	125
法人税等合計	499	168
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△2,943	△820
四半期純損失(△)	△2,943	△820

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△2,943	△820
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	0	△9
為替換算調整勘定	18	121
その他の包括利益合計	19	111
四半期包括利益	△2,923	△708
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,923	△708

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

I 前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	11,762	3,956	1,186	1,485	18,390
セグメント間の内部売上高又は 振替高	4	126	—	—	130
計	11,766	4,082	1,186	1,485	18,520
セグメント利益又はセグメント損失 (△)	268	△1,692	5	328	△1,088

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	△1,088
全社費用(注)	△265
その他	△231
四半期連結損益計算書の経常損失(△)	△1,585

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク システム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	12,664	7,531	1,499	1,473	23,168
セグメント間の内部売上高又は 振替高	18	94	1	—	114
計	12,683	7,625	1,501	1,473	23,283
セグメント利益又はセグメント損失 (△)	△215	△320	△31	287	△279

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	△279
全社費用(注)	△212
その他	△159
四半期連結損益計算書の経常損失(△)	△651

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。